



life.augmented



ST works with Qualcomm Technologies
on unique sensor solutions



意法半導體與高通科技合作，為下一代行動裝置、連網PC、 物聯網及穿戴式裝置打造獨有的感測器解決方案

【台北訊，2020年11月24日】—橫跨多重電子應用領域、全球領先的半導體供應商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）將透過參與高通Qualcomm® Platform解決方案生態系統計畫，採用高通科技（Qualcomm Technologies, Inc）的技術研發創新的軟體解決方案。此次合作將進一步擴大意法半導體感測器技術的領導地位。

在該計畫中，意法半導體為OEM廠商提供經過預先認證的MEMS和其他感測器軟體，為下一代智慧型手機、連網PC、物聯網和穿戴式裝置提供先進的功能。近期，高通科技已在其最新之先進5G行動參考平台內預選了意法半導體最新之高精度、低功耗、具備智慧感測器軟體的動作追蹤IC，以及意法半導體精確度最高的壓力感測器。

新款動作追蹤感測器iNEMO LSM6DST是一款6軸慣性測量單元（Inertial Measurement Unit，IMU），在一個高功率配置之高效系統及封裝內整合一個3軸數位加速度計和一個3軸陀螺儀。LSM6DST的功耗業界最低，在高性能模式下僅0.55mA，在加速度計模式下則僅為4μA，可以在功耗極低的狀態下無時無刻開啟高精度動作追蹤功能。LPS22HH是意法半導體業界首款具備I3C匯流排的低噪（0.65Pa）、高精度（±0.5hPa）壓力感測器，而LSM6DST搭配LPS22HH還

可提升準確度位置的追蹤功能，同時滿足最嚴謹的功率耗損限制。

對於影像應用，LSM6DST可以支援EIS和OIS（電子和光學影像防震）應用，因為該LSM6DST提供可配置的OIS專用訊號處理路徑和輔助SPI介面，以及可配置陀螺儀和加速度計訊號路徑，反過來說，輔助SPI和主介面（SPI / I²C & MIPI I3CSM）可以配置OIS。

受益於意法半導體穩定、成熟的低功耗ThELMA1製程技術，LSM6DST能支援並簡化低功耗電路設計，亦提供了連接感測器和應用處理器的I²C、MIPI I3C[®]或SPI介面。在這個慣性單元中，9KB FIFO記憶體支援動態數據批次處理，16個有限狀態機可識別來自感測器的可程式設計數據序列，並進一步降低系統級功耗。

高通科技產品管理部副總裁Manvinder Singh表示，「ST很早就了解感測器在高通科技解決方案中的重要性，多年來一直是我們的重要合作夥伴。ST在新介面（例如MIPI I3C）感測器走在市場最前列，在維持或提升感測器準確度的同時亦有效降低了產品的功率耗損。我們很高興ST能夠加入高通平台解決方案生態系統計畫，在Qualcomm[®] Snapdragon™行動平台的全時開啟（always-on）低功耗模組上，整合並優化其先進的感測器演算法。與ST等策略供應商的合作對於加速5G技術在不同垂直市場的應用至關重要。」

意法半導體類比、MEMS及感測器產品部副總裁、MEMS感測器事業部總經理Andrea Onetti則表示，「與高通科技緊密合作多年，我們能夠確保感測器之性能能滿足下一代行動裝置、穿戴式裝置，以及支援Qualcomm[®] Sensor Execution Environment環境的軟體解決方案的嚴謹要求，其中包括先進功能，例如，智慧型手機和行動PC的鉸鏈或折疊角偵測，並讓這些功能無縫整合、更快上市，以滿足全球客戶的需求。業界功耗最低的高精準度IMU搭配高準確度、可靠的時漂溫漂均極其低的壓力感測器，可滿足目前e911和eCall所要求的最高定位準確度。」

Qualcomm和Snapdragon是Qualcomm Incorporated（高通有限公司）的商標或註冊商標。

Qualcomm Snapdragon和Qualcomm Sensor Execution Environment是Qualcomm Technologies, Inc（高通科技）和/或其子公司的產品。Qualcomm Platform Solutions Ecosystem計畫是Qualcomm Technologies, Inc.和/或其子公司的計畫。

關於意法半導體

意法半導體（STMicroelectronics; ST）擁有46,000名半導體技術、產品和方案的創新和創造者，掌握半導體供應鏈和最先進的製造設備。作為一家獨立的半導體設備製造商，意法半導體與逾十萬客戶、上千合作夥伴一起研發產品和解決方案，共同打造生態系統，一同攜手應對各種挑戰和機會，滿足世界對於永續發展之更高的需求。意法半導體的技術讓人們出行更智慧、電力和能源管理更高效、物聯網和5G技術應用更廣泛。詳情請瀏覽意法半導體公司網站：

¹ ThELMA（微陀螺儀和加速度計厚外延層）是意法半導體獨特的表面微加工製程，整合薄厚可變之多晶矽層製造感測結構和互連線，使加速度計和陀螺儀的機械元件能夠整合在一個晶片上。

<http://www.st.com> °

###

媒體聯絡人

意法半導體

何艾純 Vicky Ho

資深企業公關

電話：+886-2-6603-2505

手機：+886 919 563 977

Email： vicky.ho@st.com